

各 位

会 社 名            T O W A 株 式 会 社  
代 表 者 名        取締役社長執行役員 三浦 宗男  
                         (コード番号 6315 東証プライム市場)  
問 合 せ 先        執行役員経営企画本部長 中西 和彦  
                         TEL (075) 692 - 0251

## パッケージ形状にとらわれないシングュレーション技術確立

TOWA株式会社は、半導体の用途拡大や生産効率拡大のために活用が期待できるフレキシブルな切断ニーズに応える新たなシングュレーションプロセスを確立いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 技術について

##### (1) 概要

AI や電気自動車 (EV)、ウェアラブル製品など半導体の用途拡大や、半導体製造プロセスにおけるコストや生産性改善のため、半導体パッケージの多様化ニーズが高まっています。また、パッケージニーズの多様化により、様々な形状にフレキシブルに対応できる切断プロセスが求められています。

これらのプロセス課題に対応すべく、当社はレーザ事業を展開する子会社である TOWA レーザフロント株式会社と共同で、レーザを用いたシングュレーション技術を確立いたしました。

この技術により、リードフレーム上に様々な配列でチップを配置することが可能になり、半導体製造プロセスにおけるコストや生産性向上に寄与いたします。また、半導体において一般的な四角形ではない異形状のパッケージ切断が可能となり、半導体デザインの自由度を高め搭載効率向上や半導体の用途拡大にも寄与いたします。

さらに、レーザを用いたドライ切断プロセスは、シングュレーション工程における水の使用量を 100%削減します。そのため、顧客工場での水使用量の削減にも大きく貢献できます。

##### (2) 本技術の適用製品：「LSG1040」 (2025年3月発売開始)

#### 2. 今後について

既に今後3年間で20台程度の引き合いを頂いており、ニーズが多様化するパッケージ切断に対し、引き続き最適なプロセス提案を行うことでシングュレーション装置市場でのシェア拡大を目指します。

以上